

TPT Wire Bonder

产品名称	TPT Wire Bonder
公司名称	北京锐峰先科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPT 型号:HB10
公司地址	北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦4015室
联系电话	13911457960

产品详情

TPT Wire Bonder

HB10 楔形&球键合机

马达驱动的Z轴

+ 楔形、球、凸点和带键合

+ 17 μ m至75 μ m引线和25 μ m X 250 μ m 线带

+ 6.5 ” 液晶触摸屏

+ 深腔键合，楔焊16mm/球焊13mm

+ 键合臂长165mm

+ 100个程序的存储能力

+ 马达驱动的Z轴

+ USB备份

+ 电子球径控制

+ 吸取&放置选项

+ 拉力测试选项

+ 铜线键合选项

HB10 热超声键合机用于楔形&球键合

HB10是一台桌上型键合机，是实验室、试点或小批量生产线的理想设备。仅仅需要更换劈刀，一个键合头就可以适用于球/楔或楔/楔键合模式。用触摸屏容易操作。所有键合参数可以直接进入并进行简单的调节。

技术规格

键合方法 楔 - 楔，球 - 楔，带 - & 凸点 - 键合

金线直径 17 - 75 μm (0.7-3mil)

铝线直径 17 - 75 μm (0.7-3mil)

带尺寸 最大25x250 μm (1x8mil)

超声系统 62kHz 传感器 PLL控制

超声功率 0 - 10 W输出

键合时间 0 - 10 秒

键合力 5 - 150 cNm (350cNm可选)

劈刀 1.58，长19mm (0.0624 " x0.75 ")

马达驱动的线轴 50.8mm (2 ")

断线 键合头切断/夹子切断

送线角度 90度

夹子移动 马达驱动上/下移动

球径控制 电子控制

马达驱动Z轴行程 17mm (0.67 ")

缝焊深度 165mm (6.7 ")

微调平台移动 10mm (0.4 ")

机构比 6:1

温度控制器 高达250 +/-1

电力需求 100-240V +/-10% , 50/60Hz , 最大10A

外形尺寸 680x640x490mm

重量 净重42kg